



# Customer Approve Sheet For Product Change

## 客户产品变更表

\*PCN 编号: P170703

\*发行日期: 2017/07/03

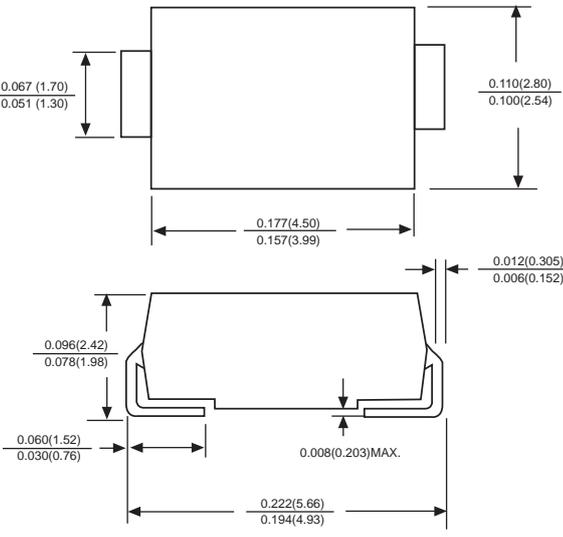
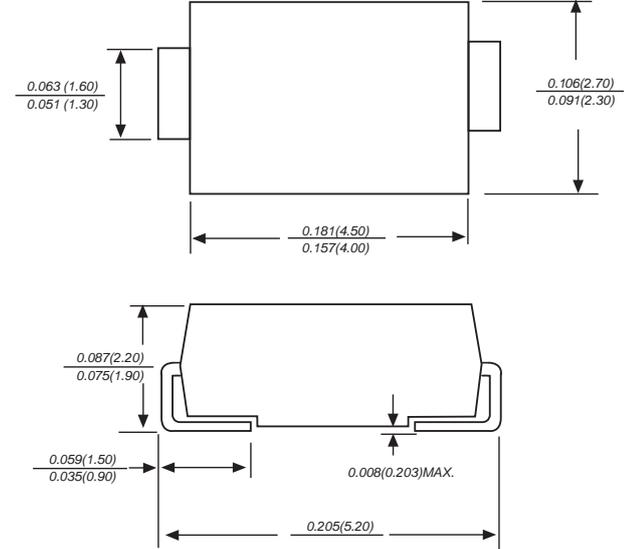
\*标题: SMA-OJ打扁更改为SMA-G框架式

\*生效日期: 2017/07/03

影响产品类别: SMA封装产品外形

Page: 1/1



<b>Emergency</b> 紧急情况	<input checked="" type="checkbox"/> Normal 正常 <input type="checkbox"/> Urgent 紧急	Apply to 适用	<input checked="" type="checkbox"/> Front End 前段 <input type="checkbox"/> Back End 后段
<b>Change Item</b> 变化项目	<input checked="" type="checkbox"/> Material 材料 <input type="checkbox"/> Design 设计 <input checked="" type="checkbox"/> Process 制程 <input type="checkbox"/> Equipment 设备 <input type="checkbox"/> Others 其它		
<b>Purpose for Change</b> 改变目的	1.采用GPP玻璃钝化芯片, 玻璃钝化层致密, 厚度均匀, 耐高温性能强, 环保 2.框架式SMA产品工艺稳定性及品质更能得到保证, 封装晶粒尺寸得到改善		
<b>Description of Change</b> 修改描述	变更前  打扁SMJ-OJ外观尺寸图如下:  	变更后  框架式SMA-G外观尺寸图如下:  	



# Customer Approve Sheet For Product Change

## 客户产品变更表

\*PCN 编号: P170703

\*发行日期: 2017/07/03

\*标题: SMA-OJ打扁更改为SMA-G框架式

\*生效日期: 2017/07/03

影响产品类别: SMA封装产品外形

Page: 2/2

<b>Relevant Verification Report</b> 相关验证报告	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Test Report (as the attachment) 性能对比报告(如附件1) <input type="checkbox"/> Mechanical Test Report (as the attachment) 机械测试报告 <input type="checkbox"/> Optical Test Report (as the attachment) 光学测试报告	
<b>Change Item(s) Confirmation</b> 变更项目确认	1. Impact on Application: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No 产品应用影响 2. Product ID: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No 产品编号	3. Cost Impact: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No 成本影响 4. BOM Change: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No BOM变更 5. Impact on other items: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No 其它影响项目
<b>Other Related Item</b> 其它相关项目	N/A	
<b>Sample availability</b> 样品供货	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
<b>Customer Approve</b> 客户批准	<input type="checkbox"/> Approve 同意 <input type="checkbox"/> Conditional Approve 有条件同意 <input type="checkbox"/> Disapprove 不同意	
<b>Customer Requirement</b> 客户需求	(N.A. , Old sample buy, new sample request.....etc) 购买旧的样品, 新样品需求 Signature : _____ Date: _____ 签名日期	

备注: 请贵公司收到此函5个工作日内给与答复, 如果超过5个工作日未收到贵公司回复, 则表示贵公司默认此次变更。

\*Attachment:

附件:无

QRA Leader: \_\_\_\_\_ Product Leader: \_\_\_\_\_ Project Leader: \_\_\_\_\_  
 品质主管 产品主管 工程主管

Sales Manager: \_\_\_\_\_ Sales Director: \_\_\_\_\_  
 销售经理 销售总监

Vice General Manager: \_\_\_\_\_ General Manager: \_\_\_\_\_  
 副总经理 总经理

附件1: SMA-OJ打扁与SMA-G框架性能对比

项目	MDD打扁SMA-OJ	MDD框架SMA-G
外形照片		
优缺点	<p>A、采用酸洗芯片，工艺简单，高温性能差，工艺不环保；</p> <p>B、采用滚镀工艺，镀层不均匀，影响使用；</p> <p>C、打扁芯片装片时，在梯盘中反复摇晃多次装入石墨舟，良率降低，且芯片表面极易被划伤，造成封装后测试漏电偏大；</p> <p>D、通过装引线、芯片焊片、盖上引线，压紧进炉烧结，中间环节皆为人工操作；</p> <p>E、引脚打扁成型，容易打裂本体、引脚歪斜不对称，引脚宽度不一致，对内部芯片结构造成压力损伤，使得漏电偏大或者正向阻抗偏大。</p>	<p>A、采用GPP芯片，工艺稳定，玻璃钝化层致密，厚度均匀，环保；</p> <p>B、挂镀工艺，镀层均匀；</p> <p>C、芯片精准定位，点锡、装片、焊接过程瞬间自动化完成；</p> <p>D、自动化切筋，磨具精准；</p> <p>E、高温性能好，漏电流较小，明显优于打扁；</p> <p>F、良率和总体合格率高，品质优于打扁。</p>